

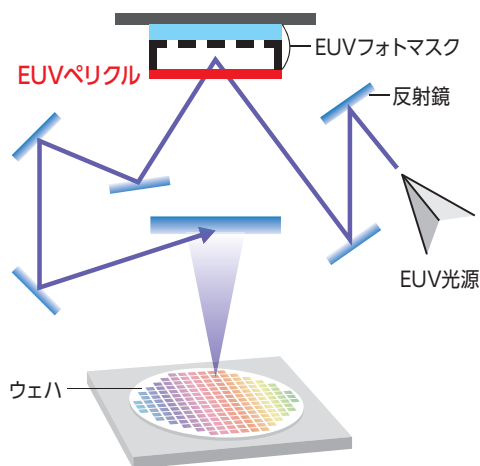
当社は成長分野に位置づける半導体関連事業に研究開発費などを積極的に投じ、将来にわたる競争力を磨き続けています。今号では、研究開発や本格生産に向けた取り組みを推進しているEUV露光機用CNT(カーボンナノチューブ)ペリクルの最新情報のほか、4月に本格受注を始めた半導体関連の新装置をご紹介します。

CNT製ペリクルの開発と本格生産に向けた取り組みを加速

ペリクルとは、半導体製造工程においてフォトマスク(回路パターン原版)への異物の付着を防ぐ防塵膜の役割を果たす部材です。従来はポリシリコンなどをベースとする素材が使われてきましたが、近年は先端半導体の微細回路形成に不可欠なEUV露光機の性能向上に伴い、より高耐久で信頼性の高いCNT製ペリ

クルが求められています。当社グループでは、CNTシートの開発を手がける米国・テキサス州の研究開発拠点においてペリクルの開発に着手し、2023年に要素技術を確認した後、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)先端半導体研究センターとの共同研究に着手するなど、社会実装へ取り組んできました。

そしてこのたび、茨城県の産総研つくばセンター中央事業所内に、当社の新たな研究開発・生産拠点として「つくばイノベーションクリエーションセンター」を開設。同拠点には、先端半導体の微細回路形成に欠かせないCNT製ペリクル膜の生産設備および関連設備も導入しました。まずはフルサイズのペリクルサンプルの供給に着手するとともに、検査装置や製品供給に必要な付帯設備なども段階的に導入する計画です。お客様によるサンプル評価を基に、さらなる製品開発と本格生産に向けた取り組みを加速していきます。



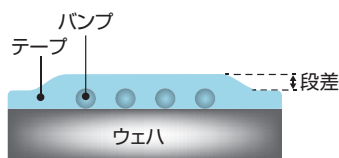
EUV露光機内のイメージ

半導体チップの歩留まり向上に貢献する 樹脂塗布プロセスを開発

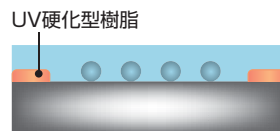
半導体チップの微細化が進むにつれ、製造工程ではウェハの裏面を平坦に研削するバックグラインド工程の重要性が高まっています。特にウェハ全体の厚みのばらつきを抑え、高い平坦性を確保することが半導体チップの品質向上に欠かせません。ただ、回路面にバンプと呼ばれる突起電極が形成されたウェハのように中央と外周部で高低差がある場合、ウェハ研削に当たり表面を保護する「バックグラインドテープ」を貼付した際、外周部に段差が生じ、これが研削時にクラック（欠けやひび割れ）が生じる原因にもなります。

そこで当社では、バンプのない外周部にUV硬化型の樹脂を塗布することでこの段差を解消し、ウェハ研削後の厚みのばらつきやクラックの発生を低減する「PCBL(Pattern Coating Before Lamination)プロセス」を開発。段差を解消するために樹脂を塗布する新装置「RAD-3400F/12」も開発し、この4月から本格受注を開始しました。同装置は塗布する樹脂のパターンや塗布量、幅や高さを調整することで、バンプの高さなどウェハの仕様に合わせたカスタマイズが可能です。当社は同装置やPCBLプロセスの提案を強化することで、半導体チップ製造における歩留まり向上へのさらなる貢献を目指していきます。

UV硬化型樹脂塗布なし



UV硬化型樹脂塗布あり



ウェハの仕様に合わせて
カスタマイズできる新装置

個人投資家向け会社説明会に参加

3月8日に大和インベスター・リレーションズ(株)主催の個人投資家向け会社説明会に参加しました。社長の服部真が登壇し、説明会参加者約250人に向けて、会社概要や製品・技術の特徴、長期ビジョン・中期経営計画などを説明しました。当日の質疑応答パートでは個人投資家の方から半導体関連事業を中心に多くの質問を頂戴したほか、会場横に設けた当社製品の展示ブースにも足をお運びいただくなど、盛況のうちに終了いたしました。今回のような会社説明会への継続的な参加を通じて、当社の知名度向上や新規個人株主の獲得などにつなげていきます。



プレゼンテーションの様子



にぎわった当社展示ブース

会社説明会の動画はこちら ▶



複数の主要IR評価機関から高評価を獲得

当社のIRサイトが、主要IRサイト評価機関である大和インベスター・リレーションズ(株)から優秀賞(上場企業4,122社の上位27社以内)に選ばれました。また、(株)ブロードバンドセキュリティ、日興アイ・アール(株)からも同様に高評価を獲得しました。当社は投資判断に必要な情報を投資家の皆様を提供する窓口としてIRサイトを重視しています。引き続きIRサイトの改善・充実を図ることで、投資家の皆様への適時適切な情報開示を強化して対話機会の拡大に努めるとともに、積極的な情報開示によって当社への理解促進に取り組みます。



大和インベスター・リレーションズ
「大和インターネットIR表彰2025」



ブロードバンドセキュリティ
「Gomez IRサイトランキング2025」

当社IRサイト(株主・投資家情報)を御覧いただけます。▶



会社概要 (2026年3月31日現在)

社名	リンテック株式会社 (英文: LINTEC Corporation)
本社	東京都板橋区本町23-23
設立	1934年10月15日
資本金	233億5,598万1,761円
上場	東京証券取引所プライム市場
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
従業員数	連結: 5,237人 単体: 2,673人
事業所	営業拠点: 東京、札幌、名古屋、大阪、福岡など全国11か所 生産拠点: 吾妻(群馬県)、熊谷・伊奈(埼玉県)、千葉(千葉県)、 龍野(兵庫県)、小松島(徳島県)、三島・土居(愛媛県) 研究拠点: 蕨・さいたま(埼玉県)
連結子会社	国内: 3社 海外: 37社

役員一覧 (2026年6月22日現在)

取締役		執行役員	
代表取締役会長	大内 昭彦	専務執行役員	持田 欣也
代表取締役社長	社長執行役員 服部 真	専務執行役員	峯浦 芳久
取締役	専務執行役員 海谷 健司	常務執行役員	所司 悟
取締役	専務執行役員 松尾 博之	常務執行役員	妹尾 秀男
取締役	専務執行役員 吉武 正昭	常務執行役員	三宅 英樹
取締役	常務執行役員 柴野 洋一	執行役員	西角 尚志
取締役(社外)	佐野 孝典	執行役員	山本 直樹
取締役(社外)	独立 奥島 晶子	執行役員	青木 智
取締役(社外)	独立 白幡 清一郎	執行役員	沼澤 英樹
		執行役員	川上 豪毅
		執行役員	喜井 大介
		執行役員	木村 慶太
		執行役員	清水 充
		執行役員	京極 昌一
		執行役員	星 優
		執行役員	瀬川 丈士
		執行役員	竹内 栄一郎
		執行役員	山下 淳史
		執行役員	秋和 淳
		執行役員	大森 正義
監査等委員である取締役			
取締役/監査等委員	木村 雅昭		
取締役(社外)/監査等委員	独立 大澤 加奈子		
取締役(社外)/監査等委員	独立 杉本 茂		